

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2014-010

## 天水华天科技股份有限公司董事会

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013 年度）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将截至 2013 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、2011 年非公开发行募集资金情况

###### （1）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]889 号《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 10 月以非公开的方式发行人民币普通股（A 股）32,900,000 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 11.12 元，募集资金总额为 365,848,000.00 元，扣除各项发行费用 15,330,000.00 元后，募集资金净额为人民币 350,518,000.00 元。该项募集资金已于 2011 年 10 月 21 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2011]703A173 号《验资报告》。

###### （2）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

单位：万元

| 以前年度已投入   | 本报告期使用金额   |            |          | 累计利息   | 报告期末余额 |
|-----------|------------|------------|----------|--------|--------|
|           | 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | 收入净额   |        |
| 35,201.55 |            | 0.01       | -        | 149.76 | -      |

截至 2013 年 12 月 31 日募集资金存款利息累计为 149.76 万元。

##### 2、2013 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

### (1) 实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009号《关于核准天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2013年8月12日向社会公开发行461万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额461,000,000.00元，并于2013年8月28日在深交所上市。本次公开发行可转债募集资金总额为461,000,000.00元，扣除发行费用9,666,500.00元后的实际募集资金净额为451,333,500.00元。该募集资金已于2013年8月16日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了瑞华验字[2013]第209A0002号《验资报告》。

### (2) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

单位：万元

| 以前年度已投入 | 本报告期使用金额   |            |          | 累计利息   | 报告期末余额    |
|---------|------------|------------|----------|--------|-----------|
|         | 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | 收入净额   |           |
|         | 11,363.95  | 14,999.67  | -        | 112.01 | 18,881.74 |

截至2013年12月31日该募集资金存款利息累计为112.01万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，公司募集资金的具体管理情况如下：

### 1、2011年非公开发行募集资金管理情况

2011年11月4日公司与交通银行股份有限公司天水支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2011年11月7日，公司通过募集资金专户向华天科技(西安)有限公司(以下简称“西安公司”)增资13,300.00万元，用于其进行募集资金投资项目“集成电路高端封装测试生产线技术改造项目”建设。

西安公司为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，2011年11月8日与昆仑银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议

《范本》不存在重大差异。截至 2013 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2013 年 12 月 31 日，该项募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

| 公司名称         | 专户银行名称            | 银行账号                  | 初始存放金额    | 利息收入净额 | 已使用金额     | 存储余额 |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------|------|
| 天水华天科技股份有限公司 | 交通银行股份有限公司天水支行    | 729030110018010012838 | 21,751.80 | 17.92  | 21,769.72 | -    |
| 华天科技（西安）有限公司 | 昆仑银行股份有限公司西安分行营业部 | 79102000048580000038  | 13,300.00 | 131.84 | 13,431.84 | -    |
| 合计           |                   |                       | 35,051.80 | 149.76 | 35,201.56 | -    |

上表的募集资金专户均已销户。

## 2、2013 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2013 年 8 月 28 日，公司与中国光大银行兰州分行营业部、第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》。公司对可转债募集资金实行专户存储，并对可转债募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2013 年 9 月 2 日，公司通过募集资金专户向西安公司增资 15,000.00 万元，用于其进行募集资金投资项目“40 纳米集成电路先进封装测试产业化项目”建设。

西安公司为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，2013 年 9 月 4 日与中国光大银行西安雁塔路支行和第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，对可转债募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2013 年 12 月 31 日止，《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2013 年 12 月 31 日，该项募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

| 公司名称         | 专户银行名称        | 银行账号              | 初始存放金额    | 利息收入净额 | 定期存款转入     | 已使用金额     | 存储余额      |
|--------------|---------------|-------------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|
| 天水华天科技股份有限公司 | 中国光大银行兰州分行营业部 | 51820188000035423 | 30,133.35 | 104.21 | -13,000.00 | 16,657.48 | 580.08    |
|              |               | 51820053000007049 |           |        | 6,000.00   |           | 6,000.00  |
|              |               |                   |           |        | 2,000.00   |           | 2,000.00  |
|              |               |                   |           |        | 5,000.00   |           | 5,000.00  |
| 华天科技（西安）有限公司 | 中国光大银行西安雁塔路支行 | 78720188000113556 | 15,000.00 | 7.80   | -5,000.00  | 9,706.14  | 301.66    |
|              |               | 78720181000094949 |           |        | 500.00     |           | 500.00    |
|              |               | 78720181000094785 |           |        | 500.00     |           | 500.00    |
|              |               | 78720181000094867 |           |        | 500.00     |           | 500.00    |
|              |               | 78720181000095336 |           |        | 500.00     |           | 500.00    |
|              |               | 78720181000095254 |           |        | 1,000.00   |           | 1,000.00  |
|              |               | 78720181000095500 |           |        | 1,000.00   |           | 1,000.00  |
|              |               | 78720181000095172 |           |        | 1,000.00   |           | 1,000.00  |
| 合计           |               |                   | 45,133.35 | 112.01 |            | 26,363.62 | 18,881.74 |

### 三、2013 年度募集资金的实际使用情况

#### 1、2011 年非公开发行募集资金实际使用情况

根据公司召开的第三届董事会第六次会议和 2011 年第一次临时股东大会相关决议，本次非公开发行募集资金用于“铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化”项目、“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目。

截至 2013 年 12 月 31 日，该项募集资金的实际使用情况详见附表 1、2011 年非公开发行募集资金使用情况对照表。

#### 2、2013 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况

根据公司第三届董事会第二十八次会议和 2013 年第一次临时股东大会相关决议及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转债募集资金扣除发行费用后，用于“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”项目、“40 纳米集成电路先进封装测试产业化”项目和“受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山钛微电子科技有限公司 28.85%股权”项目。

截至 2013 年 12 月 31 日，该项募集资金的实际使用情况详见附表 2、2013 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

#### 四、变更募集资金投资项目情况

公司 2011 年非公开发行募集资金项目和 2013 年公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用均未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

附表 1

2011 年非公开发行募集资金使用情况对照表（2013 年度）

单位：万元

| 项 目                 |                |             | 金额或比例      |                                                | 项 目           |                          |                  | 金 额       |          |               |
|---------------------|----------------|-------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额              |                |             | 35,051.80  |                                                | 报告期投入募集资金总额   |                          |                  | 0.01      |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额     |                |             |            |                                                | 已累计投入募集资金总额   |                          |                  | 35,201.56 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额       |                |             |            |                                                |               |                          |                  |           |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例       |                |             |            |                                                |               |                          |                  |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向       | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺的投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额                                       | 截至期末累计投入金额(2) | 截至本期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态的日期   | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化  | 否              | 20,160.00   | 11,214.41  |                                                | 11,214.41     | 100.00                   | 2012 年 12 月 31 日 | 3,079.54  | 是        | 否             |
| 集成电路高端封装测试生产线技术改造   | 否              | 29,840.00   | 13,300.00  |                                                | 13,431.84     | 100.99                   | 2013 年 12 月 31 日 | 3,874.38  | 否        | 否             |
| 集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造 | 否              | 29,900.00   | 10,537.39  | 0.01                                           | 10,555.31     | 100.17                   | 2013 年 10 月 31 日 | 3,502.64  | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计            |                | 79,900.00   | 35,051.80  | 0.01                                           | 35,201.56     |                          |                  | 10,456.56 |          |               |
| 超募资金投向              |                |             |            |                                                |               |                          |                  |           |          |               |
| 归还银行存款（如有）          |                |             |            |                                                |               |                          |                  |           |          |               |
| 补充流动资产（如有）          |                |             |            |                                                |               |                          |                  |           |          |               |
| 超募资金投向小计            |                |             |            |                                                |               |                          |                  |           |          |               |
| 合计                  | —              | 79,900.00   | 35,051.80  | 0.01                                           | 35,201.56     |                          | —                | 10,456.56 | —        | —             |
| 未达到计划进度或预计效益的情况和原因  |                |             |            | “集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目已 |               |                          |                  |           |          |               |

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 在 2013 年完成建设，项目经济效益将在达产年产能全部释放后体现。                                                                        |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 无                                                                                                         |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 无                                                                                                         |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 无                                                                                                         |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无                                                                                                         |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,956.20 万元。该笔资金已全部置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无                                                                                                         |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无                                                                                                         |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 无                                                                                                         |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                         |

说明：募集资金承诺原投资总额为 79,900.00 万元；2011 年 10 月 21 日公司实际募集资金净额为 35,051.80 万元，公司根据实际募集资金净额确定的募集资金投入总额调整为 35,051.80 万元。

附表 2

2013 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2013 年度）

单位：万元

| 项 目                                      |                |             | 金额或比例      |           | 项 目           |                             |                | 金 额       |          |               |
|------------------------------------------|----------------|-------------|------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                                   |                |             | 45,133.35  |           | 报告期投入募集资金总额   |                             |                | 26,363.62 |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                          |                |             |            |           | 已累计投入募集资金总额   |                             |                | 26,363.62 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                            |                |             |            |           |               |                             |                |           |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                            |                |             |            |           |               |                             |                |           |          |               |
| 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向                | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺的投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至本期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态的日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 通讯与多媒体集成电路封装测试产业化                        | 否              | 16,000.00   | 16,201.88  | 2,726.01  | 2,726.01      | 16.83                       | 2015 年底        | -         | 项目尚在建设中  | 否             |
| 40 纳米集成电路先进封装测试产业化                       | 否              | 15,000.00   | 15,000.00  | 9,706.14  | 9,706.14      | 64.71                       | 2015 年底        | 105.86    | 项目尚在建设中  | 否             |
| 受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%股权 | 否              | 13,931.47   | 13,931.47  | 13,931.47 | 13,931.47     | 100.00                      | 2013 年底        | -         | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                                 |                | 44,931.47   | 45,133.35  | 26,363.62 | 26,363.62     |                             |                | 105.86    |          |               |
| 超募资金投向                                   |                |             |            |           |               |                             |                |           |          |               |
| 归还银行存款（如有）                               |                |             |            |           |               |                             |                |           |          |               |
| 补充流动资产（如有）                               |                |             |            |           |               |                             |                |           |          |               |
| 超募资金投向小计                                 |                |             |            |           |               |                             |                |           |          |               |
| 合 计                                      | —              | 44,931.47   | 45,133.35  | 26,363.62 | 26,363.62     |                             |                | 105.86    |          |               |



|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计效益的情况和原因   | “通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”项目和“40 纳米集成电路先进封装测试产业化”项目还在实施过程中，投资效益将在以后年度逐步体现。                                                            |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 无                                                                                                                              |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 无                                                                                                                              |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 无                                                                                                                              |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无                                                                                                                              |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于用可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,363.95 万元。截至 2013 年 9 月 13 日，该笔资金已全部置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无                                                                                                                              |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 募集资金投资项目尚在实施过程之中。                                                                                                              |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 募集资金投资项目尚在实施过程之中，用于募集资金投资项目建设。                                                                                                 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                              |

说明：募集资金承诺原投资总额为 44,931.47 万元；2013 年 8 月 16 日公司实际募集资金净额为 45,133.35 万元，公司根据实际募集资金净额确定的募集资金投入总额调整为 45,133.35 万元。